

## 【閎康產學合作計畫】113 年徵件，5/7 起開放申請 閎康提供高階分析儀器服務

為提升新元件與新材料在研發過程中的分析檢測品質，促進產業升級，自民國 110 年始至 114 年止，閎康科技每年投入新台幣 2000 萬元整，預計每年補助 20 件專案，徵求以**開發高科技產品和製造、封裝、測試與系統等主題**，並運用先進分析檢測技術的研究計畫，支持學術單位在創新元件、材料及創新構想的先期研究及開發。每年執行期間為當年度 8/1 開始至次年 7/31 止。

### 113 年度計畫時程

- 徵件時間：自 113 年 5 月 7 日起開始收件，至 113 年 6 月 18 日截止受理。
- 結果公告：於 113 年 7 月 16 日前將遴選結果通知服務中心與申請人。
- 計畫執行時間：自 113 年 8 月 1 日起至 114 年 7 月 31 日止。

### 徵件對象

包含 **臺灣大學**、台灣科技大學、臺灣師範大學、清華大學、陽明交通大學、中央大學、中興大學、成功大學、中山大學等九校。計畫主持人需任職於受理服務中心所在機構，每人每年以申請一件為限。

### 遴選重點

- 研究主題以**量子電腦、化合物半導體、先進製程、光電材料、製造封裝、新能源**等相關領域優先。
- 具創新或未來應用發展潛力。
- 計畫之執行需使用閎康科技所提供之分析儀器。

補助項目由閎康科技提供下列尖端分析測試服務。依儀器設備分為 9 大領域：

- 1.非破壞性結構觀察 ( 3D X-ray, SAT, Thermal EMMI )
- 2.微結構與成份分析 ( 樣品製備, 高解析 TEM, SEM, FIB, EDS, EBSD, EELS, NBD, SAD )
- 3.雜質濃度檢測 ( SIMS, SRP, SCM, XPS, Auger )
- 4.污染與微量檢測 ( TOF-SIMS, XPS, FTIR, XRF )
- 5.液態 TEM 分析 ( K-kit )
- 6.元件級電性量測與缺陷定位 ( C-AFM, Nano-probing, EBIC/EBAC, PEM, OBIRCH, Thermal EMMI )
- 7.ESD ( HBM, MM, CDM, Latch-up, TLP, EOS )
- 8.可靠性測試 ( HTOL, HAST, TCT, BLT, TS, Vibration, Shock, H2S corrosion, AMR/AMI, HRTB 等 )
- 9.物理化學分析 ( ICP-MS, TGA, LC-MS 等 )

## 經費補助

閎康產學合作計畫主要希望提昇研發過程中的分析檢測品質，因此整體的預算佔比將依下述方式安排：( 僅為建議，申請人可自行估算比例，由審查專員會進行最後評核 )

- 70% 設備使用費 ( 閎康科技責儀 )
- 20% 學校管理費
- 10% 人事、材料及其他業務費用 ( 建議使用現有的人力，以減少費用的支出 )

## 簽約

依各校產學計畫相關規定辦理。

本校請洽本校研發處產學服務組各學院負責人(02)3366-6625。

## 申請方式

請依閎康科技網頁公告之產學計畫申請書格式製作文件，於期限內將電子檔郵寄閎康科技行政窗口。逾期、文件不全或不符合規定者，不予受理。

## 聯絡人

閎康行政聯絡窗口 - 邱珮如小姐 (03)611-6678 ext: 3815, JDP@ma-tek.com

閎康技術諮詢窗口 - 陳弘仁先生 (03)611-6678 ext: 3250, JDP@ma-tek.com

申請書、計畫詳情與 QA，請參考閎康科技網頁：

[https://www.matek.com/zh-TW/News\\_Release/detail/IAR/2024/20230506](https://www.matek.com/zh-TW/News_Release/detail/IAR/2024/20230506)